



### RE901

- Multiadapterplatine mit sechs Micro-Miniatur-Halbleiterschaltungen
- Epoxydglashartgewebe FR4 1,50 mm
- Einseitig 35 µm Cu
- Oberfläche chem. Ni/Au mit Lötstopplack beschichtet
- Bestückungsdruck
- Es können 20 verschiedene Halbleitertypen auf der Platine plaziert werden
- 8-poliger Stiftleistenanschluß Raster 2,54 mm
- Lochdurchmesser 1,00 mm
- Vorgeritzte Sollbruchstelle zum Trennen der Module
- Gerberdaten zur Herstellung des Lötpastenaufdrucks werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt
- Größe 22,86 x 46,72 mm

Layout	Pad (mm)	Pitch	Größe	Konfiguration	Belegung
TO252	*	*	*	*	TO252
SOT223	*	*	*	*	SOT223
SOT89	*	*	*	*	SOT89A
SOT23	0,710 x 1,000	0,950 mm	2,400 mm	2 Reihen x 3	SC59, SC74, SC74A, SMT3, SMT5, SMT6, SOT23, SOT23-5, SOT23-6
SOT23-8	0,460 x 1,100	0,650 mm	2,400 mm	2 Reihen x 4	SC70, SC88A, SOT23-8, UMT3, UMT5, UMT6
SC75	*	*	*	*	EMT3, SC75